西安瑞联新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	□特定对象调研　　√业绩说明会 □媒体采访　　□分析师会议 □新闻发布会　　□路演活动 □现场参观　　□其他
参与单位名称及人员姓名	投资者网络互动
时间	2026 年 11 月 02 日 09:00-10:00
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）;
上市公司接待人员姓名	1、董事长 刘晓春 2、董事、总经理 王小伟 3、副总经理、董事会秘书 王银彬 4、财务负责人 陈涛 5、独立董事 肖宝强
投资者关系活动主要内容介绍	**问题 1：公司此前表示持续寻找优质投资标的，重点关注电子材料和医药领域。请问目前在半导体光刻胶材料、先进封装材料及医药 CDMO 等领域，是否仍有面向非关联第三方企业的股权投资或控股并购实际需求？** 答：投资者您好！公司在持续寻找优质投资标的，重点关注电子材料和医药两大领域，标的选择上需综合考虑业务协同、标的公司发展前景和潜在风险等，未来如有确定的投资项目，公司将按照交易所的相关规定及时对外披露。感谢您的关注与支持！ **问题 2：尊敬的公司领导，近期通过公开专利检索发现，公司在‘负性光刻胶组合物’、‘低介电常数光刻胶组合物’以及封装用 PSPI 组合物领域有密集的新专利申请。此前公司多以供应单体（如 ArF/KrF 单体）为主，请问这些成品组合物专利是否意味着公司已具备直接向封测厂或面板厂供应‘成品胶’的能力？目前这些新专利处于实验室研发、中试阶段，还是已经**

	向下游头部客户送样验证？预计何时能转化为实际营收？” 答：投资者您好！“负性光刻胶组合物”和“低介电常数光刻胶组合物”两款专利对应的光刻胶组合物均为显示用光刻胶，属于公司面向下游领域开展的前沿技术储备与知识产权布局。申请这些专利，代表公司已经完成实验室技术研究，不直接等同于可以规模化对外供应成品。半导体及显示用光刻胶、PSPI 成品胶产品，认证周期长、壁垒高，涉及配方稳定性、量产工艺、客户严苛验证等多重环节，研发进展和客户验证情况等因保密限制不便披露。感谢您的关注！ **问题 3：之前公司去年提到的 8000 万 OLED 材料扩产项目，原计划 2026 年三季度末建成。请问目前是否已实际投产？三季度单季 OLED 材料的产能利用率大概处于什么水平？** 答：投资者您好！蒲城海泰高性能光电材料产业化项目目前处于调试阶段，投产计划要根据产品排产情况确定。本年度 OLED 业务小批次、多批量的情况显著增加，对反应釜的占用率较高。感谢您的关注！ **问题 4：医药板块在前三季度的实际营收占比大概是多少？其毛利率水平与去年同期相比是持平、提升还是下降？** 答：投资者您好！2026 年前三季度医药板块收入占比 15%左右，受汇率及产品结构因素影响，毛利率略有下降。感谢您的关注！ **问题 5：尊敬的公司领导：财报显示公司前三季度研发费用高达 9600 多万，且近期新专利申报密集。但短期利润因研发和新产能折旧承压明显。请问管理层，这些密集的知识产权布局，主要是为了匹配蒲城海泰明年及后年（2027-2028）即将投产的 200 吨 PSPI、OLED 扩产专线，还是为了开拓全新的产品线？公司预计这波由专利转化带来的‘研发红利’，大概在哪个财报节点能对冲掉前期的资本开支，真正体现在利润表的毛利率回升上？**

	答：投资者您好！公司高度重视技术研发，专利知识产权布局反映了公司未来业务的发展重点，为中长期发展做好技术沉淀。毛利率变化受产品结构、汇率、下游行业景气度、市场竞争环境等多重影响，无法锁定具体财报节点。公司将全力加快市场拓展、推进产能建设，优化成本结构，努力将技术储备转化为经营成果。感谢您的关注！ **问题 6：刘总您好：半年报时公司提到半导体材料营收大增、PSPI 单体稳定供货。但三季报没有详细拆分。请问三季度单季，半导体光刻胶单体和 PSPI 的营收增速是否依然维持了上半年的势头？规划的 200 吨 PSPI 新产能，目前的厂房建设和设备调试进展到了哪一步？是否有国内头部客户的验证突破？** 答：投资者您好！第三季度半导体光刻胶单体材料和 PSPI 单体材料营收同比依然呈现高速增长的态势。蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目已开始进行设备采购。感谢您的关注！ **问题 7：尊敬的公司领导：三季报显示‘支付给职工以及为职工支付的现金’同比增加了约 3100 万，叠加研发费用和在建工程增加，直接导致当期利润承压。** **有看公司的公众号，2026 年校招了 107 名毕业生，今年公司也在开展校招。结合公司‘一中心多基地’布局，公司预计何时能够度过这轮‘人员与产能前置储备期’，迎来人效和毛利率的双重拐点？** 答：投资者您好！公司新增校招人员集中在生产、研发等岗位。人效及毛利率的改善受产品结构、汇率、下游行业景气度、市场竞争环境等多重影响，无法确定具体时间节点。公司将持续做好人才培养、降本增效，加快技术成果产业化落地，稳步改善盈利水平。感谢您的关注！ **问题 8：刘总您好，您刚提到的“电子材料板块应收实现大幅增长，产品线涉及半导体光刻胶单体、PAG、PSPI 单体、TFT-**

	INK 封装胶单体等多个品种”，能否介绍下报告期内，电子材料同比增长多少？现在销售额低多少？ 答：投资者您好！报告期内前三季度电子材料板块核心产品持续出货，带动板块营收同比增幅超 100%。感谢您的关注！
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息的情形。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 6 日